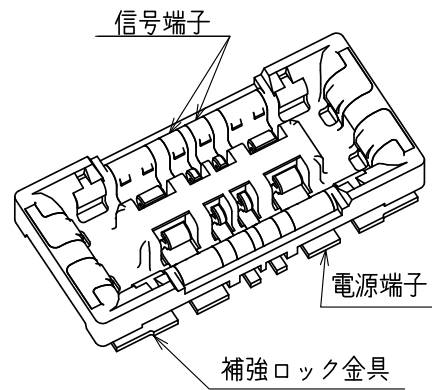
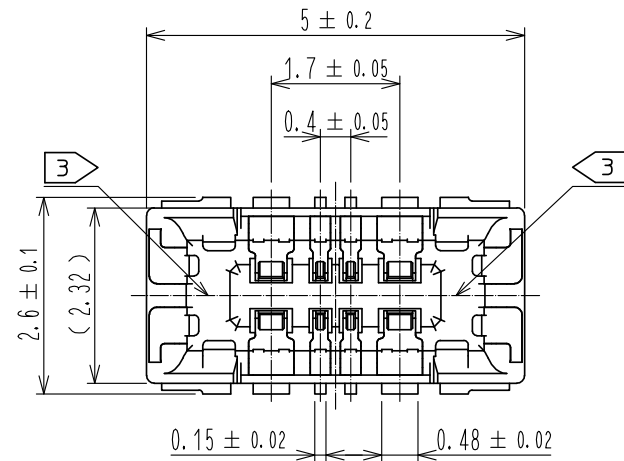
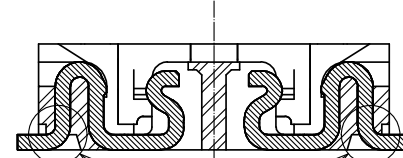


Mar.1.2024 Copyright 2024 HIROSE ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.
本製品を車載用途などの高い信頼性が求められる機器にご使用の場合は、弊社までお問合せ下さい。

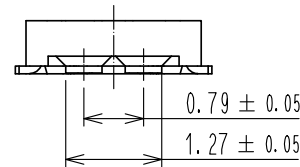
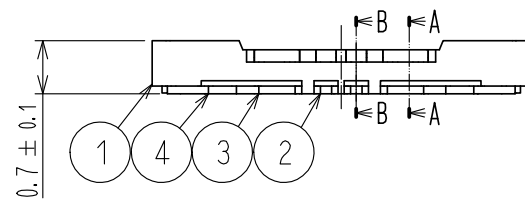
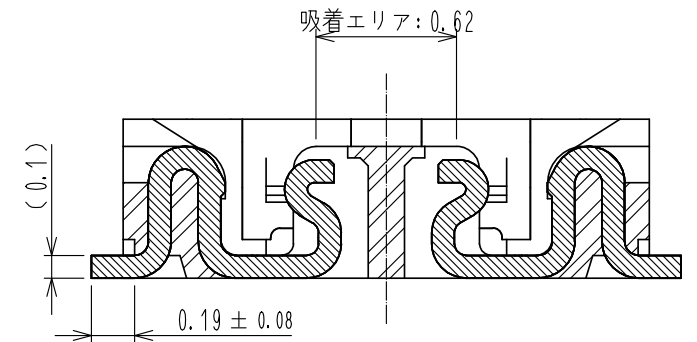


はんだ上がり防止機構

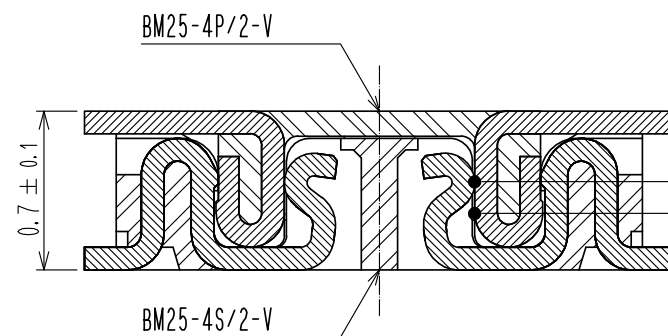


一体成型することで
はんだ上りを防止します。

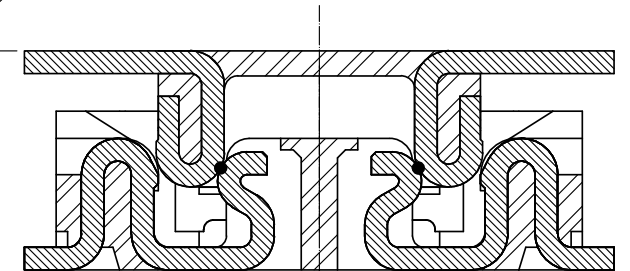
A-A (30:1)
B-B (30:1)



嵌合断面図 (20:1)



有効接触長
(電源端子, 信号端子)



有効嵌合長
(電源端子, 信号端子)

注 1. 平坦度は0.08mm以内です。

2. 端子、金具めっき仕様

接触部 : 金めっき0.05μm以上

リード部 : 金めっき0.05μm以上

下地 : ニッケルめっき1μm以上

(表面 : 封孔処理)

3. 図示近辺にHRSマーク又はCAV No. を示します。

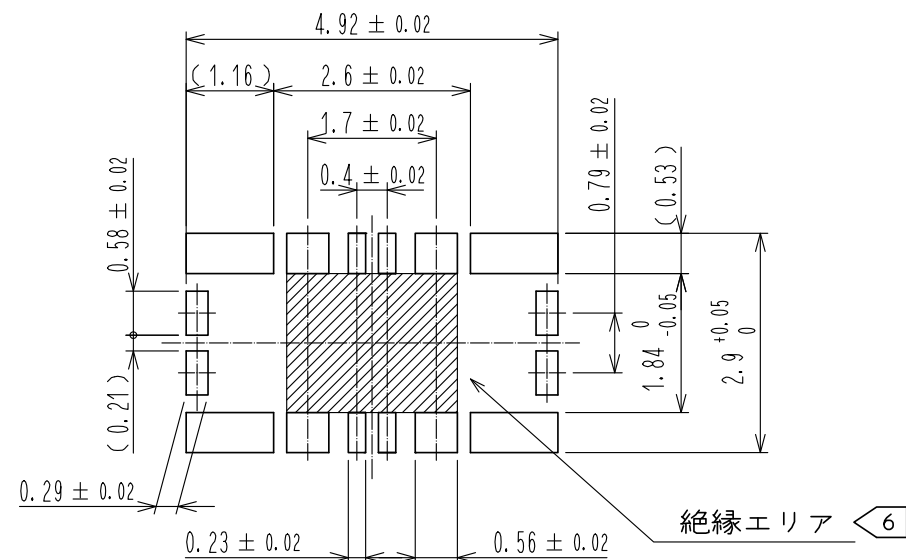
4	銅合金		8	PS	CLEAR(補強用カラー)		
3	銅合金		7	PS	BLACK(プラスチックリール)		
2	銅合金		6	ポリエステル	CLEAR(カバーテープ)		
1	LCP	UL94 V-0, BLACK	5	PS	CLEAR(エンボスキャリアテープ)		
NO.	MATERIAL	FINISH . REMARKS		NO.	MATERIAL	FINISH . REMARKS	

UNITS mm		SCALE 10 : 1		COUNT	DESCRIPTION OF REVISIONS	DESIGNED	CHECKED	DATE
HIROSE ELECTRIC CO., LTD.		APPROVED	: WR. FUKUCHI		20200116	DRAWING NO.	ADC-358233-53-00	
		CHECKED	: TS. MIYAZAKI		20200116	PART NO.	BM25-4S/2-V(53)	
		DESIGNED	: KT. KUSAKA		20200116	CODE NO.	CL677-1200-0-53	
		DRAWN	: MN. SATOH		20200116			

	1	4
--	---	---

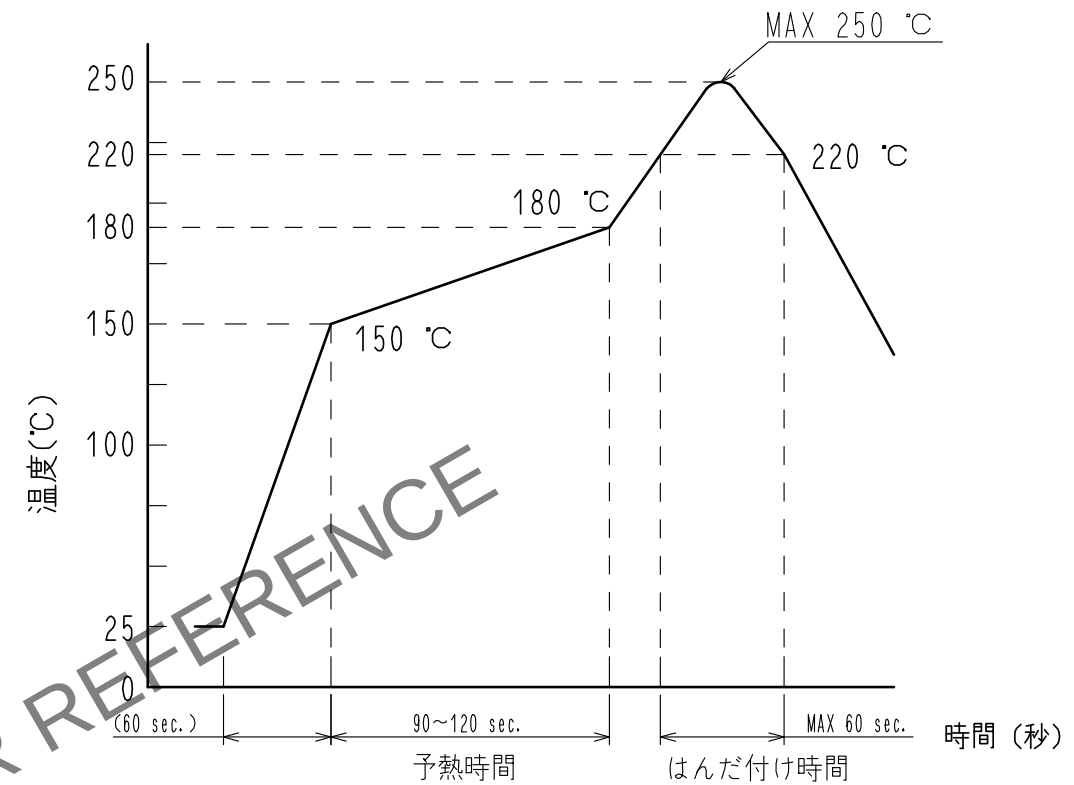
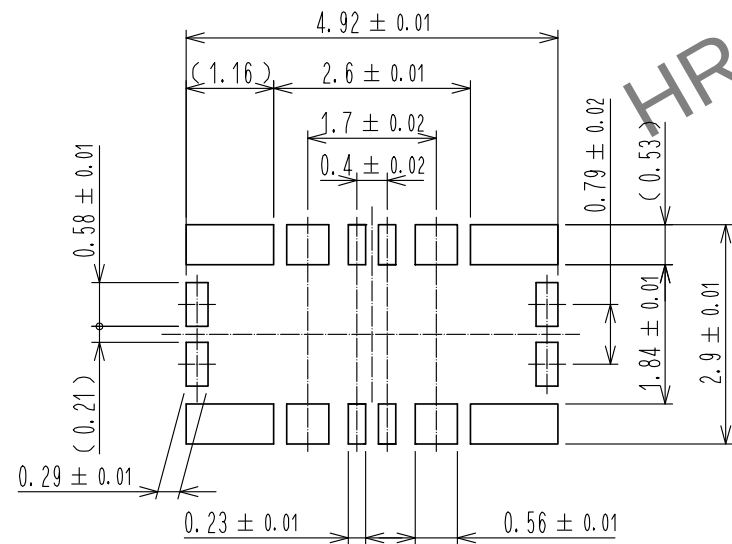
4 鉛フリークリームはんだの温度プロファイル（推奨）

◆推奨パターン図



◆メタルマスク開口部推奨加工図

メタルマスク厚さ：100 μm（開口率：100%）



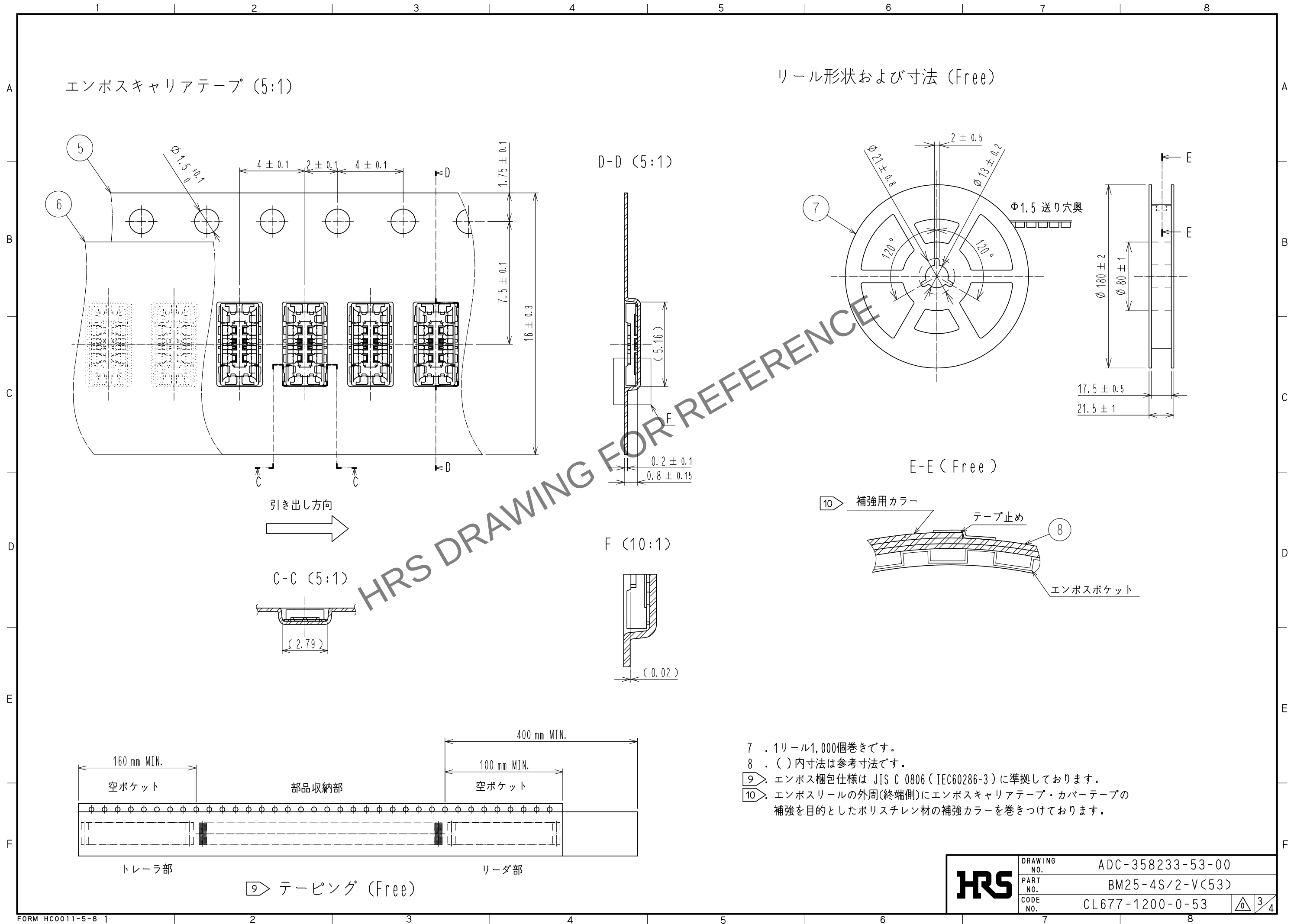
リフロー方式：IRリフロー
リフローは2回以下とします。
1) リフロー部
220℃以上 60秒以下
（ピーク温度250℃）
2) プリヒート部
150～180℃ 90秒～120秒

- 4 温度はコネクタリード部近辺の基板表面温度を表します。
この温度プロファイルは上記適用条件のものです。
クリームはんだの種類、メーカー、基板サイズ、その他実装部材等の条件により異なる場合がありますので、実装状態を十分ご確認の上ご使用願います。
- 5 上記の推奨条件と、異なる設定を行なう場合は、弊社にご連絡を下さい。
- 6 このエリアの基板表面にパターン配線する場合は、レジストなどにより絶縁を施してください。

HRS

DRAWING NO.	ADC-358233-53-00
PART NO.	BM25-4S/2-V(53)
CODE NO.	CL677-1200-0-53

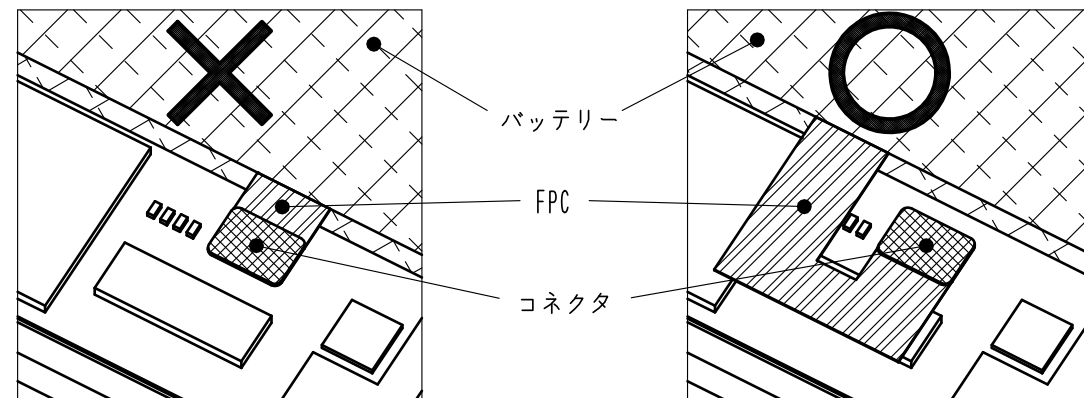
Mar.1.2024 Copyright 2024 HIROSE ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.
本製品を車載用途などの高い信頼性が求められる機器にご使用の場合は、弊社までお問合せ下さい。



Mar.1.2024 Copyright 2024 HIROSE ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.
本製品を車載用途などの高い信頼性が求められる機器にご使用の場合は、弊社までお問合せ下さい。

■FPC引き回しの注意点

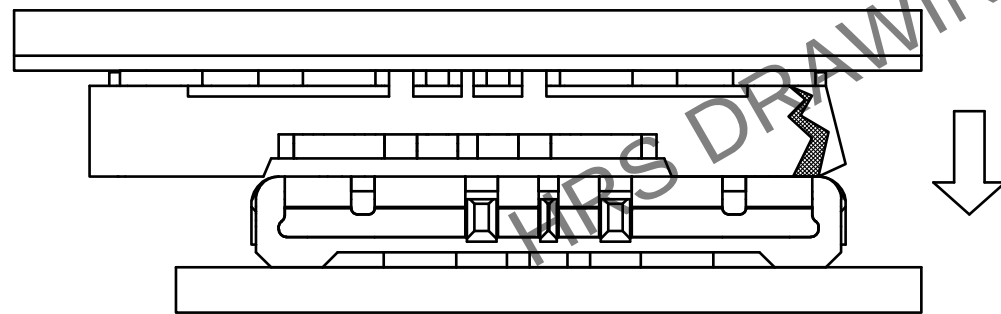
BM25はバッテリー向けの10A通電を想定したコネクタとなっております。
10A通電のFPCは銅箔の幅が広く厚くなるため通常よりフレキシブル性が劣る可能性があります。
FPC設計は基板とバッテリーの固定によるコネクタの位置ズレ*を吸収させるため
フレキシブル性を持たせた設計を検討してください。



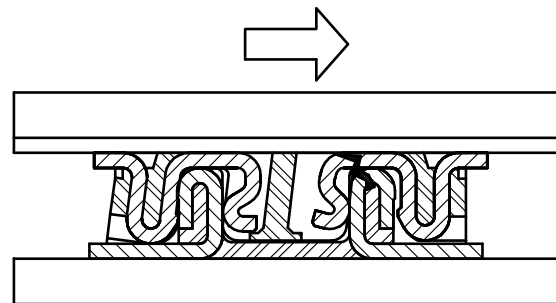
*コネクタ位置ズレに対する懸念点

コネクタが位置ズレした状態での嵌合はコネクタの機能を損なう可能性があります。

- ① 位置ズレ嵌合はコネクタのケースを破損する恐れがあります。



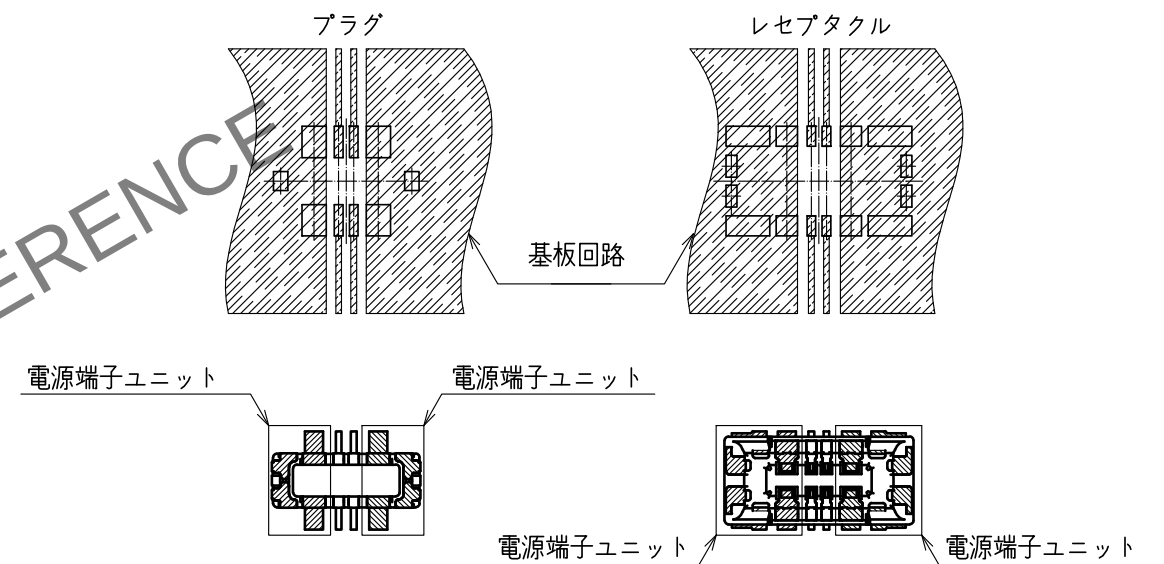
- ② 位置ズレ嵌合はコネクタの端子片側に過度な負荷を与える可能性があります。



■パターン設計の注意点

下図に示す様に、補強ロック金具を含む各電源ユニットは、
同一の基板回路上に実装される様にしてください。

◆推奨基板回路図



HRS

DRAWING NO.	ADC-358233-53-00
PART NO.	BM25-4S/2-V(53)
CODE NO.	CL677-1200-0-53

4/4